

2026年3月第3週:グローバル・テクノロジー&トレード・レポート

AI特需の加速と新秩序の形成

テーゼ：力を持つ者が価格を決める新時代

「2030年まで続く 『チップフレーション』の時代へ」

— SKグループ会長による市場予測

圧倒的な需要 (Force) と、物理的・地政学的な摩擦 (Friction) が衝突し、半導体業界は「構造的なインフレ」という新たなパラダイムへ突入している。

AIインフラへの巨額資本投下

110兆ウォン

サムスン電子、閣議決定による歴史的投資計画。TSMCを凌駕する資本力で主導権奪還へ。

売上3倍増 (\$23.8B)

マイクロン。台湾での「第2 HBM工場」建設により供給体制を強化。

2nm以下の 限界突破

imec。ASMLの最新鋭「High-NA EUV」を導入し、極微細化研究が本格始動。

AIシリコン覇権争い：3つの生存戦略モデル

■ 覇権国 (The Hegemon)

■ 反乱軍連合 (The Rebels)

■ 独立国家 (The Sovereigns)

NVIDIA

サムスン × AMD

Meta

アプローチ:
「学習」のGPU + 「推論」のLPUによるハイブリッド戦略。

最新動向:
200億ドルでの資産買収後、初の「Groq 3 LPU」を発表。

アプローチ:
TSMC依存からの脱却と、次世代メモリの優先確保。

最新動向:
次世代AI向け「HBM4」優先供給。3nm/2nmファウンドリ協力の検討。

アプローチ:
極限の垂直統合と専用インフラ構築による「脱エヌビディア」。

最新動向:
自社専用AIチップ「MTIA」の驚異的な6ヶ月開発サイクル。

地政学リスク：トランプ政権の「管理された貿易」



パリ閣僚級会談（休戦の模索）

3月末のトランプ・習近平会談に向けた地ならし。関税、レアアース、農産物購入が主な交渉カード。



新たな輸出規制枠組み

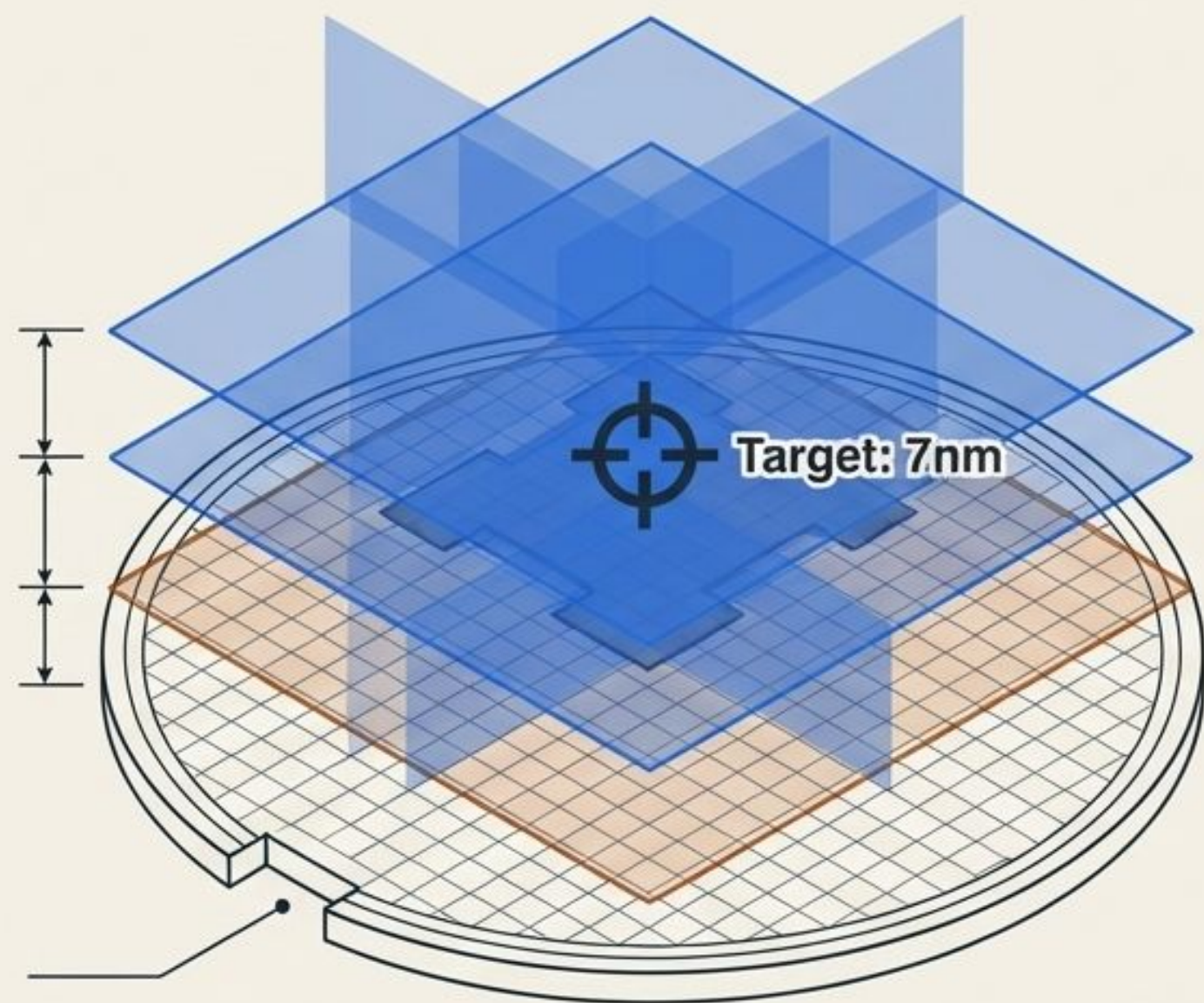
先端半導体の対中輸出が「個別審査」へ移行

25%の追加関税

厳格な再輸出スキーム：
「米国 一度輸入 → セキュリティ検査 → 関税支払い」を義務化

中国の猛追：技術的制裁の突破口

華虹半導体（Hua Hong）による7nmプロセス量産の実現。



Step 1: 旧型装置（DUV）の使用。

Step 2: DUV多重露光
（Multi-patterning）による精度
向上。

Step 3: 北京政府による「半導体
自給自足」への強力な資金援助が
コスト度外視の製造を可能に。

サプライチェーンの死角：密輸スキーム

企業：Super Micro | 被害総額：\$2.5 Billion

1



米国港からの正規輸出。

2



第三国（ダミー拠点）への経由。

3



前代未聞の偽装工作。「ドライヤーでラベルを張り替え」原産地を偽装。

4



中国データセンターへの不正転送完了。

グローバル・サプライチェーンの脆弱性マップ



ENERGY

ホルムズ海峡の緊張

イラン紛争激化。トランプ政権による同盟国への「軍艦派遣」要請。原油高リスク。



RESOURCES

マレーシア「ヘリウム危機」

半導体洗浄に不可欠なガスの供給不安定化。「中立な製造点」を脅かす原材料の弱点。



90,000

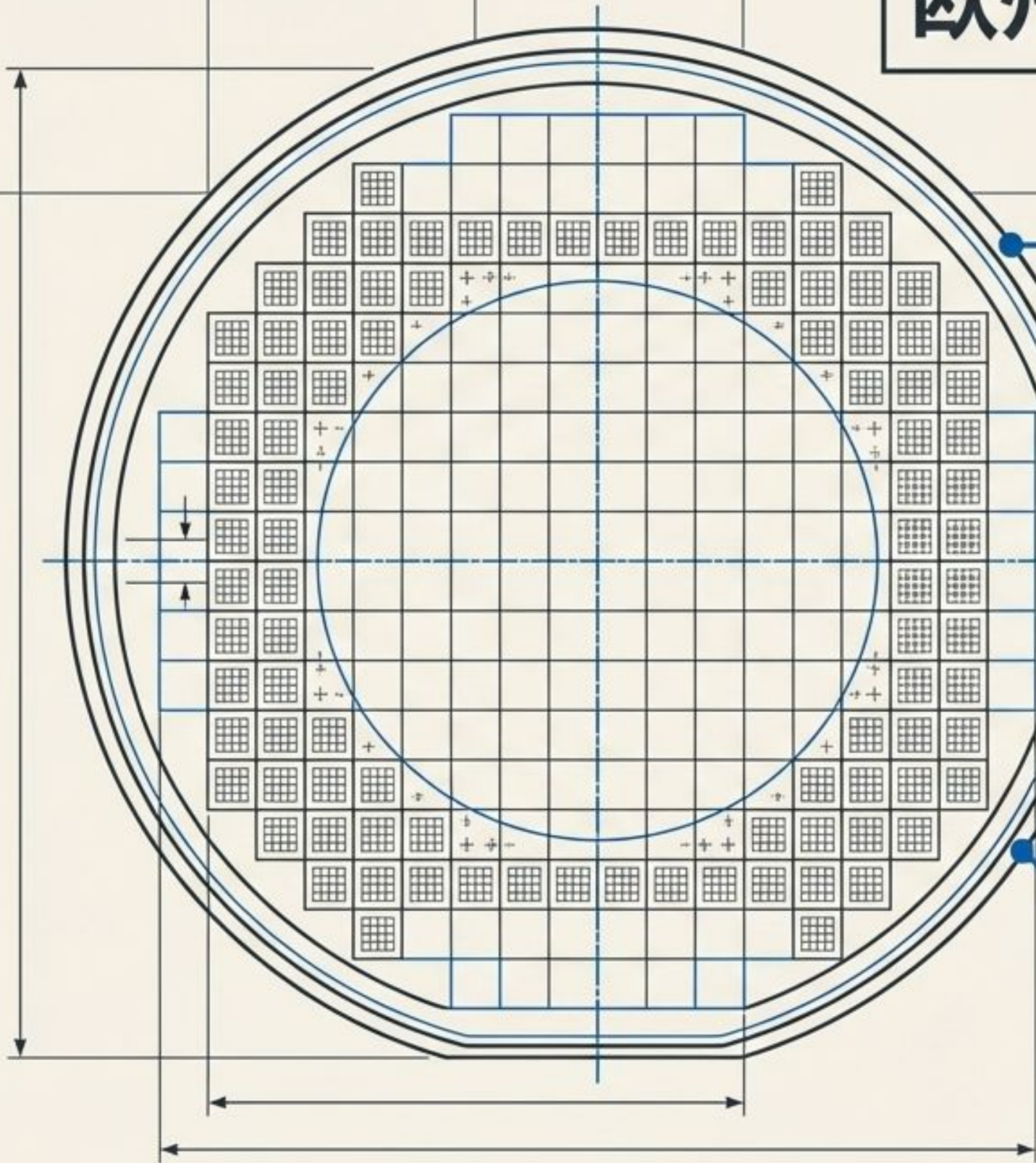
9万人のストライキ・リスク

サムスン労働組合（全従業員の7割）がスト決議。5月決行なら世界供給が半減の恐れ。

注記：日本の製造業景況感は+18（4年ぶり高水準）だが、円安と原油高が先行きの懸念材料に。

欧州の焦燥：成熟プロセスの防衛戦

インフィニオンからの緊急提言

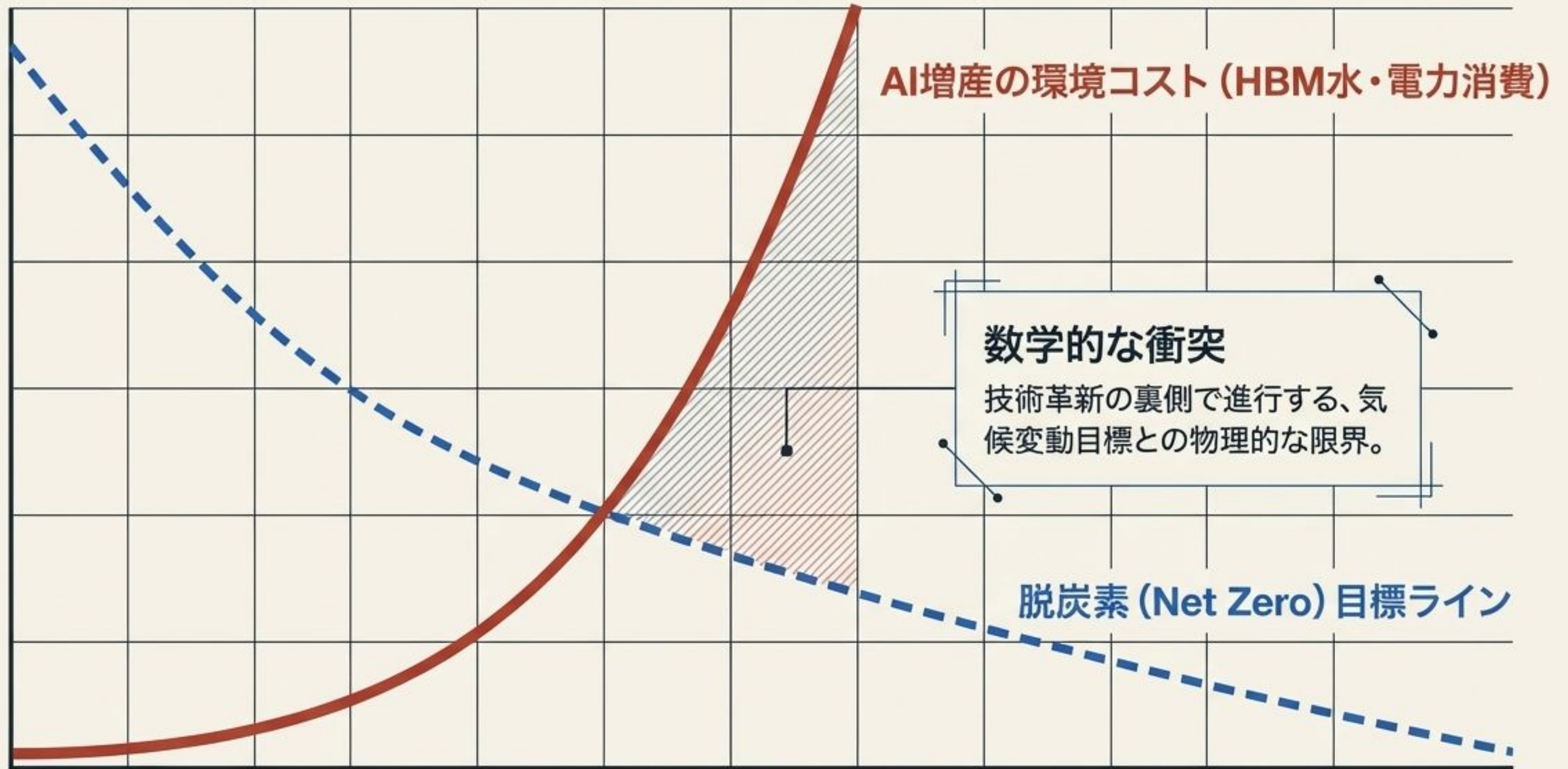


脅威のシフト：中国による「成熟プロセス（レガシー半導体）」への圧倒的な投資攻勢に対する危機感。

防衛戦略：欧州全工場の「300mm ウェハー化」への完全移行。

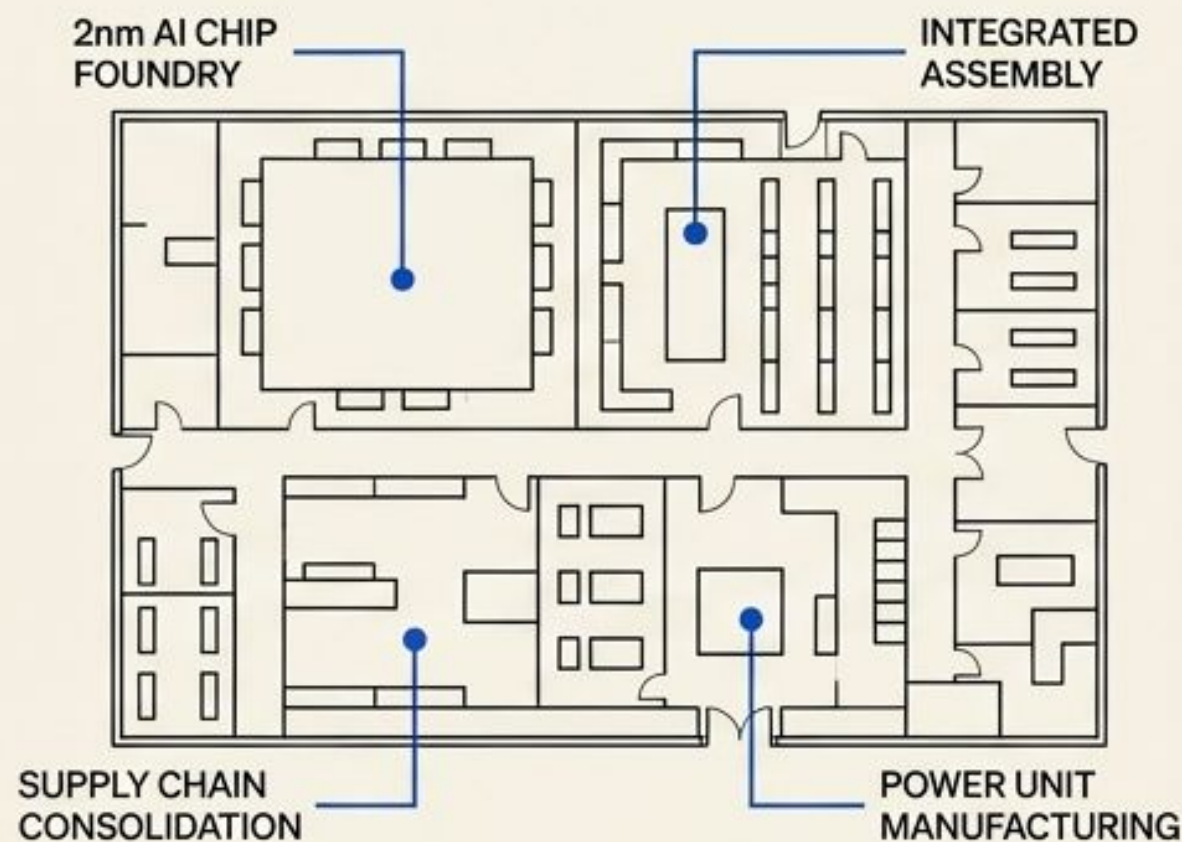
競争力強化：極限まで高度化された自動化への転換によるコスト競争力の維持。

AI増産の「環境コスト」とパラドックス



新パラダイム：極限の垂直統合と完全自動化

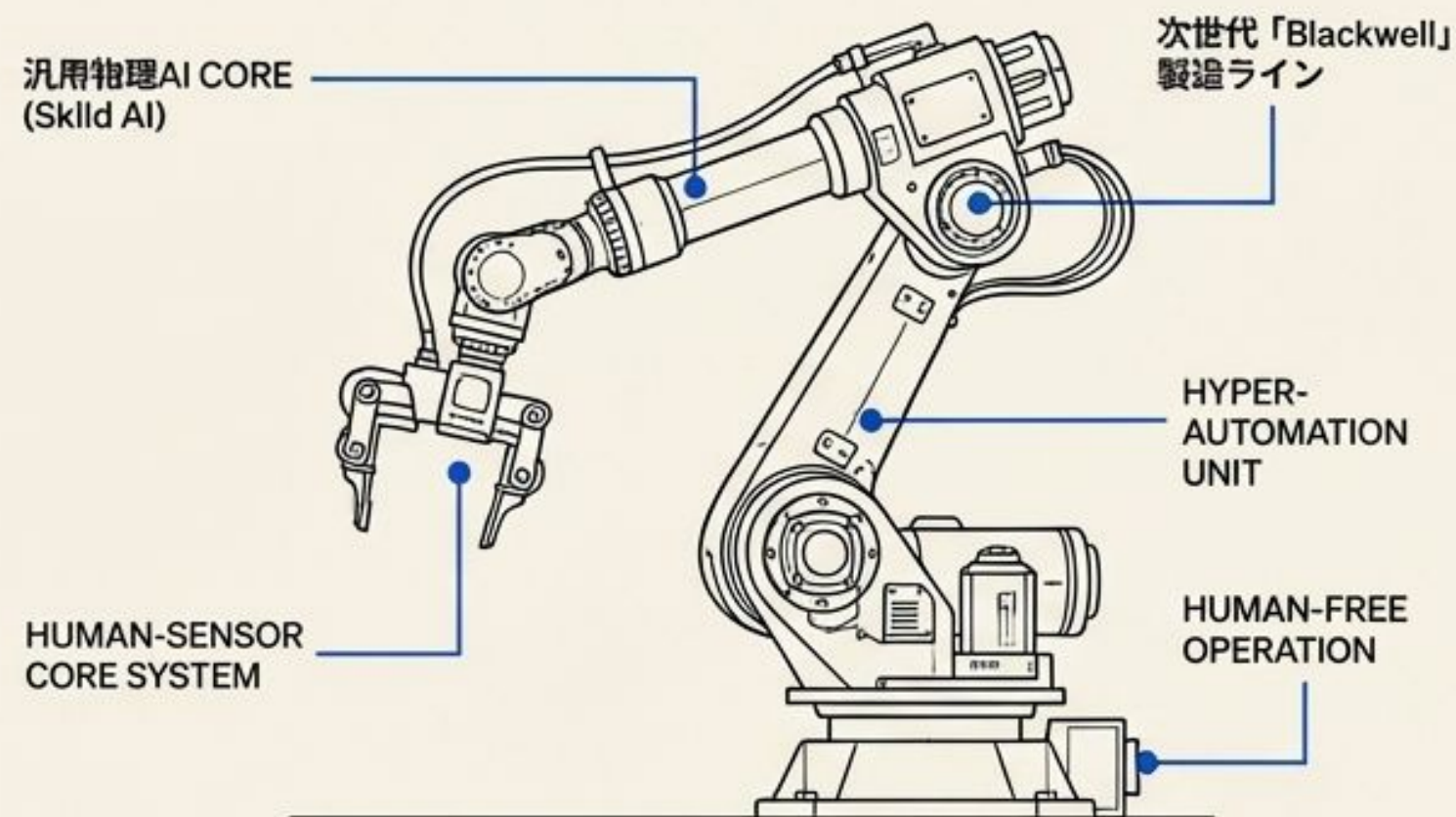
自動車メーカーから「垂直統合型半導体メーカー」へ
テスラ「Terafab」プロジェクト



イーロン・マスクの野望。自社で2nm AIチップを製造する巨大工場プロジェクト始動。サプライチェーンの完全内製化。

労働力不足を補う「完全自動化」

Skild AI × NVIDIA



次世代「Blackwell」製造ラインへの「汎用物理AI」ロボット導入。人間（労働組合・ストライキリスク）に依存しない製造現場の革命。

結論：構造的「チップフレーション」の不可避性

巨額のAIインフラ投資 (+\$73B規模)

+

関税・セキュリティ検査・密輸対策コスト

+

資源不足・労働組合ストライキによる供給ショック

+

膨張する環境・エネルギー対応費

=

構造的チップフレーション
(Structural Chipflation)

一時的な需給逼迫ではない。2030年に向けて、半導体の製造・調達コストはシステム全体として不可逆的に上昇し続ける。「力を持つ者」が価格を決定する新秩序が、今週完成した。